PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-038299

(43) Date of publication of application: 07.02.1995

(51)Int.Cl.

H05K 13/08

B23P 21/00

H05K 13/02

(21)Application number: **05-180563**

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND

COLTD

(22) Date of filing:

22.07.1993

(72)Inventor:

KANEMATSU KOICHI

TAKEMURA MIWAKO

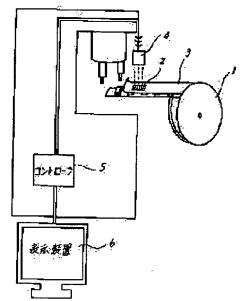
MASUDA SEI KAWAI MAKOTO

(54) CONTROLLING METHOD OF ELECTRONIC COMPONENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a method for controlling electronic components which can obtain the information on the replenishment period of electronic components and information on components required for packaging the components and then reduce the working stop time of an electronic components packaging machine in the electronic packaging machine for mounting the electronic components on a printed circuit board.

CONSTITUTION: With a bar code label 2 recording the number of electronic components to be mounted of an electronic component assembly 1, information needed for mounting, component name, shape, arrangement, characteristics, and storage direction, especially the bar code label 2 for the number of electronic components to be mounted, information on the number of electronic components to be mounted and packaging is read from the electronic component assembly 1 where a plurality of bar code labels 2 are



applied, thus enabling a monitoring personnel to determine the information on the number of electronic components to be mounted of the electronic component assembly 1 which are provided and components required for packaging before packing and to determine a replenishment period in advance according to the remainder of the electronic components.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.07.2000

[Date of sending the examiner's decision of

10.12.2002

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-38299

(43)公開日 平成7年(1995)2月7日

(51) Int.CL*	\$	配号	庁内監理番号	ΡI	技術表示箇所
H05K 13/	/08	A	8315-4E		
B 2 3 P 21/	/00 3 (5 B	7181-3C		
HO5K 13/	90/	В	8509-4)E		

審査請求 未請求 菌求項の数2 OL (全 5 頁)

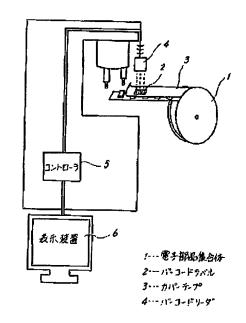
(21)出廢番号	特顧平5-180563	(71) 出題人 000005821 松下和器産業株式会社
(22)出籍日	平成5年(1983)7月22日	大阪府門寫前大字門寫1006番弟
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(72) 発明者 兼松 宏一
		大阪府門兵市大字門真1006番地 松下電器
		<u> </u>
		(72) 発明者 竹村 美和子
		大阪府門兵市大字門兵1006番地 松下電器
		產業練式会社內
		(7%)発明者 益田 聖
		大阪府門其市大字門真1006番池 松下電器
		産業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 森本 森弘
		最終質に続く

(54) 【発明の名称】 電子部品管理方法

(57)【變約】

【目的】電子部品をプリント基板に実装する電子実装機において、電子部品の循充時期、部品を実装するために必要な部品の情報を把握し、電子部品実装機の稼動停止時間を減らすととができる電子部品管理方法を提供する。

【構成】電子部品集合体1の電子部品類報数置、実装するために必要な情報、部品名称、形状、配列、特性、収納方向を記録したパーコードラベル2を、少なくとも電子部品搭載数量についてのパーコードラベルは複数個貼付した電子部品集合体1からその搭載数置、真装の情報を読み取るようにする。したがって、実装前に装備されている電子部品集合体1の電子部品搭載数置、実装に必要な部品の情報を監視者が知ることができ、電子部品の残数量に応じて事前に締充時期を把握できる。



【請求項1】 電子部品実装機に供給する電子部品の集 台体に、一定の間隔で未使用部品の搭載置を複数個記載 し、前記記載内容を読み取り、電子部品の残数を管理す ることを特徴とする電子部品管理方法。

1

【語求項2】 電子部品夷装機に供給する電子部品の集 台体に、電子部品を実態するために必要な情報である部 品名称、形状、配列、特性、収納方向を記載し、前記記 戴內容を読み取り、電子部品集合体を正しい状態に管理 することを特徴とする電子部品管理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電子部品をプリント基 板に実態する電子部品の管理方法に関するものである。 [00021

【従来の技術】従来、電子部品実装機における電子部品 残骸管理形態としては、実装中ある電子部品集合体の電 子部品がなくなったとき、電子部品実装機からの実装エ ラーメッセージに応じて、監視者が部島の減り具合いを 観測し、残数管理している。また、実装織からの部品切 26 れに関するエラーメッセージに応じて部品の掛け替えを 行っている。

【りり03】次に、部品供給コニットとこれを用いた! PCステーションによる従来の電子部品残数管理方法に ついて説明する。図4に示すように、部品供給ユニット 8の記憶手段チップ形!Cメモリ9にリール内全入り数 をバーコード化された電子部品の搭載数置として記憶さ せ、読み取り手段10において実装数量をカウントし、 搭載敷置から実装数置を減算して残穀量を出し、この残 数量が所定値に達すると補充指示手段が電子部品の循充 30 を指示することにより、電子部品の残骸置に庇じて電子 部品の箱充時期を把握している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな従来の残骸管理方法では、1つ1つの部品供給ユニ ットに搭載した電子部品集合体が空になる前に他の電子 部品集合体、または部品供給ユニットを再利用した場 台、実装エラーのエラーメッセージが出るまではいつ部 品切れになるのか部品補充時期を知ることができない。 したがって、電子部品実装機の稼働中、監視者は部品切 40 れを常に監視していなければならないという問題があ る.

【0005】その上、いつ部品切れになるかを事前に知 ることが困難であるため、部品切れ発生後に部品補充を 行うことになる結果、部島切れ発生から部品補充完了ま で電子部品実装機の稼働停止時間が長くなるという問題 もある。

【0006】また、部品切れ発生後、監視者が電子部品 集合体の掛け替えを行う際に、集合体の部品内容がわか

2 テーションでの残数管理には、かなりの設備投資を行わ なければならないという問題点がある。

【りり07】本発明は上記従来の問題を解決するもの で、電子部品集合体が空になる前に他の電子部品集合体 または部品供給ユニットを再利用したとしても、電子部 品の補充時期を正確に管理できるとともに部品を実施す るために必要な部品の情報を把握し電子部品集合体の正 しい状態を管理できる電子部品管理方法を提供すること を目的とする。

19 [0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明の電子部品管理方法は、電子部品実装機に供 給する電子部品の集合体に、一定の間隔で未使用部品の 搭載量を複数個記載し、この記載内容を読み取ることに より電子部品の残数を管理するものであり、さらに、電 子部品を実装するために必要な情報である部品名称、形 状、配列、特性、収納方向を記載し、この記載内容を読 み取ることにより電子部品集合体を正しい状態に管理す るものである。

[0009]

【作用】本発明は、上記した構成によって、電子部品集 台体が空になる前に他の電子部品集合体または部品供給 ユニットを再利用する場合でも、部品実装する前に電子 部品集合体内容電子部品の残数を読み取ることにより電 子部品集合体内の搭載数量を正確に確認できる。また、 部品実装する前に電子部品集合体内電子部品の部品名 称、形状、配列、特性、収納方向を読み取り、その情報 を設備のもつ情報と照合することにより電子部島集合体 内の電子部品の情報を確認できる。また、電子部品の搭 裁数量と実装に必要な情報を読み取る読み取り装置は、 ICメモリを備えた従来のIPCステーションシステム に比べ、安価に備えることができるため、設備投資額を 少なくすることができる。

[0010]

【実施例】以下本発明の一実施例を図面に基づいて説明 する。図1は本発明の一実施例の電子部品管理方法を実 施するための全体構成を示す戦略図である。図1におい て、電子部品集合体1に搭載された電子部品の部品名 称、形状、配列、特性、収納方向の情報を記録し、さら に電子部品の搭載量を記録してあるバーコードラベル2 がカバーテープ3に一定の間隔で貼着されている。 電子 部品実装機には、このバーコードラベル2の読み取り装 置であるパーコードリーダ4が取り付けられ、コントロ ーラ5が実装機の情報のやりとりを行って電子部品の管 理を行い、CRTモニタ6はそれちを表示する。

【0011】なお、バーコードラベル2の貼付位置およ び貼付方向はバーコードを読み取ることができるなち は、綴、儀どちらでも構わないし、バーコードラベル2 の貼付間隔は1個ないし複数個単位で良い。また電子部 らず、掛け替えミスが生じる。この他、図4のIPCス 50 品の部品名称、形状、配列、特性、収納方向の信報は最 先のパーコードラベルに記録するだけでもよい。さらに パーコードラベル2の貼付位置は、図2に示すように、 部品テープ7の部品間位置であっても構わない。このと きパーコードラベル2の読み取りはカバーテープ3が剥 がれてから行われる。

【0012】以上の構成における部品管理方法の手順を図3に示すフローチャートに基づいて説明する。ステップ11で電子部品集合体1を電子部品実装機の部品供給部にセットした後、ステップ12でバーコード化された部品名称、形状、配列、特性、収納方向に関する情報を10該み取る。電子部品集合体1が装備された場合、以前の電子部品集合体1の配列、収納方向が記録されているので、ステップ13で設備の部品名称、形状、配列、特性、収納方向に関する情報と照合し、正しい状態が否が判断する。もし、NOであれば、ステップ14にてCR下モニタに不照合内容表示する。ステップ15でステップ14の指示にしたがい正しい状態にし、ステップ13にロス

[0013]次に、ステップ16でその部品の絡載数置 ! を読み取る。なお、接属中の電子部品集合体1が変に 20 なって新たな電子部品集合体1が接属された場合、以前の電子部品集合体1の最終絡載数置。たとえばゼロが記録されているので、ステップ17において、搭載数置1が所定数A(たとえば「1」で、この所定数Aは、任意に設定できるものとする。)以上であるか否か判断することにより、CRTモニタ6が表示している搭載数置がこの電子部品果合体1のものであるか否かが判断される。もし、NOであれば、ステップ18で電子部品の領充指示ランプ点灯状態になり、ステップ19にて、電子部品集合体1の交換を行う。このとき、ステップ13に 30 戻り、交換後の電子部品について電子部品の情報、搭載数量1を判断し、YESならばステップ20~ステップ21にて実装をスタートする。

【0014】とのように本実施例によれば、電子部品集 台体1のカバーテープ3に搭載数置を示すバーコードラ ベル2を貼着し、バーコードリーダ4に読み取らせ、さ ちにCRTモニタ6に表示させたり、帳票としてプリン* * 夕出力することにより、常に監視者によって部品残数を 監測したり、高価な残数管理システムを投資するという 従来の問題点を解消するととができる。また、電子部品 の部品名称、形状、配列、特性、収納方向の情報も各電 子部品集合体毎に持つことができる。

[0015]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、部品実装する前に電子部品集合体内の電子部品の残数を読み取り、表示装置により残数を確認でき、また、電子部品の接続に関する情報も確認できる。また、電子部品の搭載置を読み取る読み取り装置は、「Cメモリを備えた従来残骸管理システムに比べ、安価に備えることができるため、設備投資額を少なくすることができる。

【0016】さらに、従来は部品切れになってからの機 様の停止により部品供給時期を把握していたが、本発明 は実装前に享前に残数を知ることが可能なため、監視者 が常に部品切れを監視するという必要がなくなり、新し い部品集合体を付けかえる準備ができているため部品切 れによる実装機停止時間を削減できる。また、電子部品 集合体内の電子部品の部品名称も管理できるので、電子 部品集合体の掛け替えを行う際に、掛け替えミスが生じ ることもない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の電子部品管理方法を実装するための全体構成を示す機略図

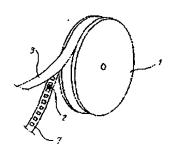
【図2】本発明の一実施例の電子部品管理方法に使用する電子部品集合体の他の例を示す斜視図

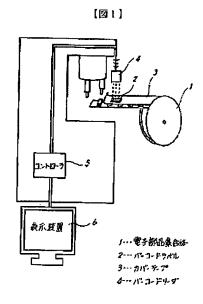
【図3】本発明の一真施例の電子部品管理方法のフローチャート

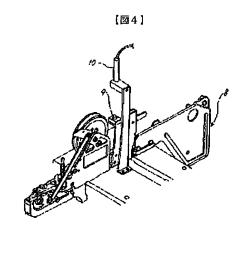
3 【四4】従来の部品供給ユニットの斜視図 【符号の説明】

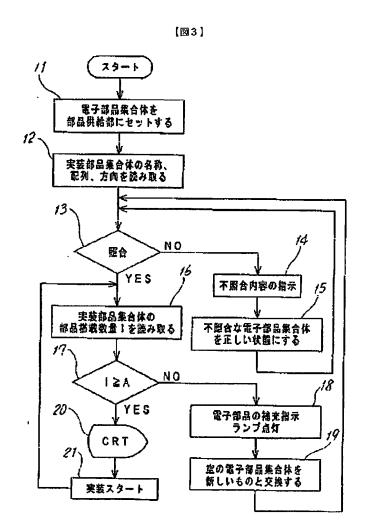
- 1 電子部品集合体
- 2 バーコードラベル
- 3 カバーテープ
- 4 バーコードリーダ
- 5 コントローラ
- 6 CRTモニタ

[図2]









フロントページの続き